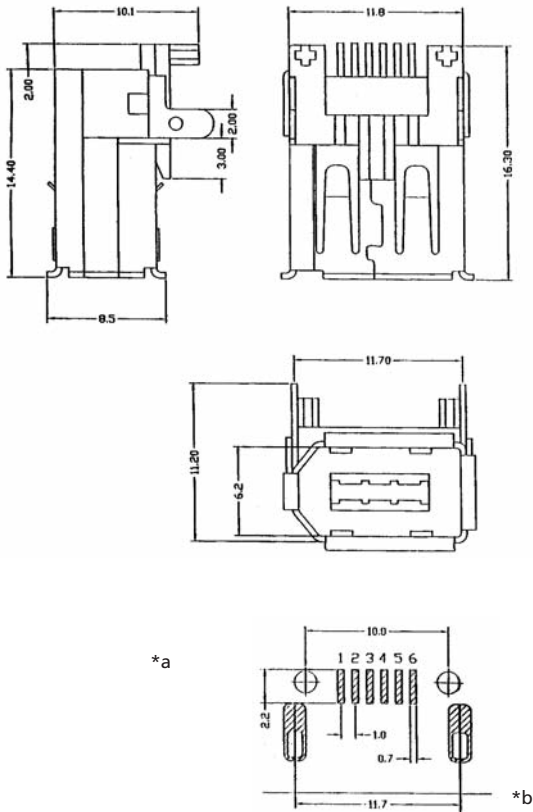




**SMT**



\*a Leiterplattenlayout  
printed circuit board layout  
modèle de carte imprimée

\*b Leiterplattenrand  
printed circuit board edge  
bord de carte imprimée

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
<b>2417 02</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

Verpackung: im Tablett  
Packaging: in tray  
Emballage: en tableau

**2417 02**

IEEE-1394-Einbaukupplung, 6-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

**1. Werkstoffe**

Kontaktträger	HTN GF
Kontakt	CuSn, selektiv vergoldet
Gehäuse	CuSn, verzinkt

**2. Mechanische Daten**

Kontaktierung mit	IEEE-1394-Steckern 2311, 2316
-------------------	-------------------------------

**3. Elektrische Daten**

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	≤ 1 A
Bemessungsspannung	30 V AC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

**2417 02**

IEEE 1394 socket, 6 poles, angular version, for printed circuit boards, surface mounting technology (SMT)

**1. Materials**

Insulating body	HTN GF
Contact	CuSn, selectively gilded
Shell	CuSn, tinned

**2. Mechanical data**

Mating with	IEEE 1394 plugs, 2311, 2316
-------------	-----------------------------

**3. Electrical data**

Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	≤ 1 A
Rated voltage	30 V AC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

**2417 02**

Embase femelle IEEE 1394, 6 pôles, version angulaire, pour cartes imprimées, technologie des montages en surface (SMT)

**1. Matériaux**

Corps isolant	HTN GF
Contact	CuSn, doré sélectivement
Boîtier	CuSn, étamé

**2. Caractéristiques mécaniques**

Raccordement avec	connecteurs mâles IEEE 1394 2311, 2316
-------------------	--

**3. Caractéristiques électriques**

Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	≤ 1 A
Tension assignée	30 V AC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ